

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

739

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

19.08.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

Polyimid 50µ -18µ eins CU Kleberlos 460x305...	50201120	<div>18</div> <div>50</div>	VS	<div>1</div>	
A-RS-FR4-Prepreg-106-LowFlow-R1551LE	50200912	<div>50</div>		<div>2</div>	A01
C-RS-FR4-DS-1.20mm-018+018-TG150-HF	50200899	<div>18</div> <div>1164</div> <div>18</div>	L2 L3	<div>3</div>	A02
A-RS-FR4-Prepreg-106-TG150-HF	50200640	<div>91</div>		<div>4</div>	
A-RS-FR4-Prepreg-106-TG150-HF	50200640	<div>0</div>		<div>5</div>	
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	<div>18</div>	RS	<div>6</div>	

Dicke nach Verpressen

B00:

1440 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1595 µm

Dmin:

1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1550 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1705 µm

Dmin:

1395 µm

Messstelle:

(05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1427 µm

Version 1.2.16.21

© Würth Elektronik